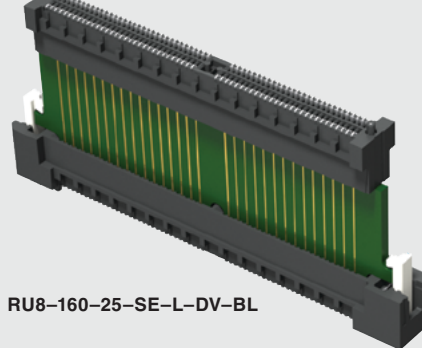
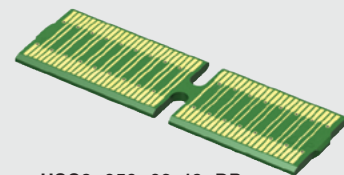




RU8-160-25-SE-L-DV-BL



HSC8-050-02-19-DP

(0.80 mm) .0315"

RU8, HSC8 SERIES

HIGH-SPEED RISER CARD KIT

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?RU8

CONNECTOR

Insulator Material:

Black LCP

Contact:

BeCu

Plating:

Au or Sn over 50 μm (1.27 μm) Ni

Current Rating:

3.1 A per pin (6 adjacent pins powered)

Operating Temp:

-55 °C to +125 °C

PROCESSING

Lead-Free Solderable:

Yes

SMT Lead Coplanarity:

(0.10 mm) .004" max (40-60)

RoHS Compliant:

Yes

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



Note: While optimized for 50 Ω applications, this connector with alternative signal/ground patterns may also perform well in certain 75 Ω applications.

RU8	1	POSITIONS PER ROW	STACK HEIGHT	SIGNAL ROUTING	PLATING OPTION	DV	BL	OTHER OPTION
		40, 50, 60	-19 = (19 mm) .748" -25 = (25 mm) .984" -30 = (30 mm) 1.180"	-SE = Single-Ended -DP = Differential Pair	-L = 10 μm (0.25 μm) Gold on contact, Matte Tin on tail (Plating for connectors) Plating for Card is Hard Gold		-BL = Board Locks (Bottom Socket only) (Not available on -19 stack height)	Leave blank for Trays -K = (5.50 mm) .217" DIA Polyimide Film Pick & Place Pad -TR = Tape & Reel

Kit contains two connectors and one card. Assembly required.

Note: Other Gold plating options available.

NO. OF POSITIONS PER SIDE	A	B	-SE TOTAL SIGNAL LINES	-DP TOTAL SIGNAL PAIRS
40	(39.80) 1.567	(51.05) 2.010	40	26
50	(47.80) 1.882	(59.05) 2.325	50	32
60	(55.80) 2.197	(67.05) 2.640	60	38

Note: Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

Mates with:

HSEC8

SPECIFICATIONS

For complete specifications see www.samtec.com?HSC8

Conductor:

1/2 oz Copper

Contact Area:

Hard Gold Plated

Insulator:

FR-4

RoHS Compliant:

Yes

NO. OF POSITIONS PER SIDE	-SE TOTAL SIGNAL LINES	-DP TOTAL SIGNAL PAIRS
-40	40	26
-50	50	32
-60	60	38

Note:

Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.

HSC8	NUMBER OF POSITIONS PER SIDE	CARD STYLE	STACK HEIGHT	SIGNAL ROUTING
	-040, -050, -060	-02 = (1.60 mm) .062" thick card	-19 = (19 mm) .748" -25 = (25 mm) .984" -30 = (30 mm) 1.180"	-SE = Single-Ended -DP = Differential Pair

Note: Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

STACK HEIGHT	A
-19	(14.84) .584
-25	(20.84) .820
-30	(25.84) 1.017

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9